

# 2025年2月期 第1四半期 決算説明資料

---



2024年7月12日  
ローツェ株式会社  
証券コード：6323  
<https://www.rorze.com/ir>

# 注意事項

## ◆ 将来見通しに関する記述について

本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しの変動する可能性があり、今後予告なく変更されることがあります。

## ◆ 本資料における表示方法について

数 値： 単位未満を切り捨て

比 率： 1円単位の金額で計算後、単位未満四捨五入

会計年度： 年度開始日の暦年表記（「2025年2月期」を「FY2024」または「FY'24」と表記）

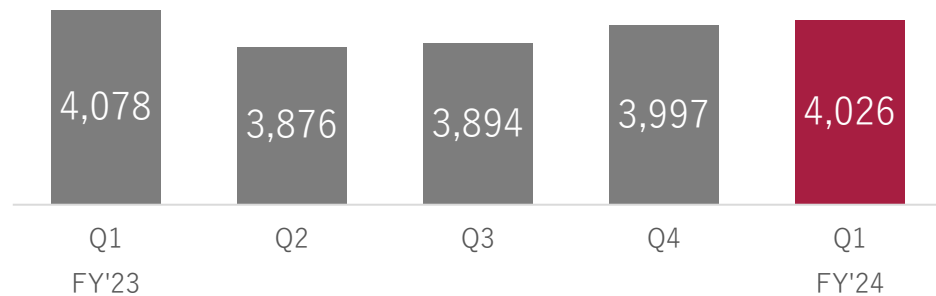
会計期間： 連結・当社、国内および海外子会社の会計期間は次のとおり

	Q1 (第1四半期)	Q2 (第2四半期)	Q3 (第3四半期)	Q4 (第4四半期)	通 期
連結・当社・国内子会社	3月～5月	6月～8月	9月～11月	12月～翌年2月	3月～翌年2月
海外子会社	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～12月

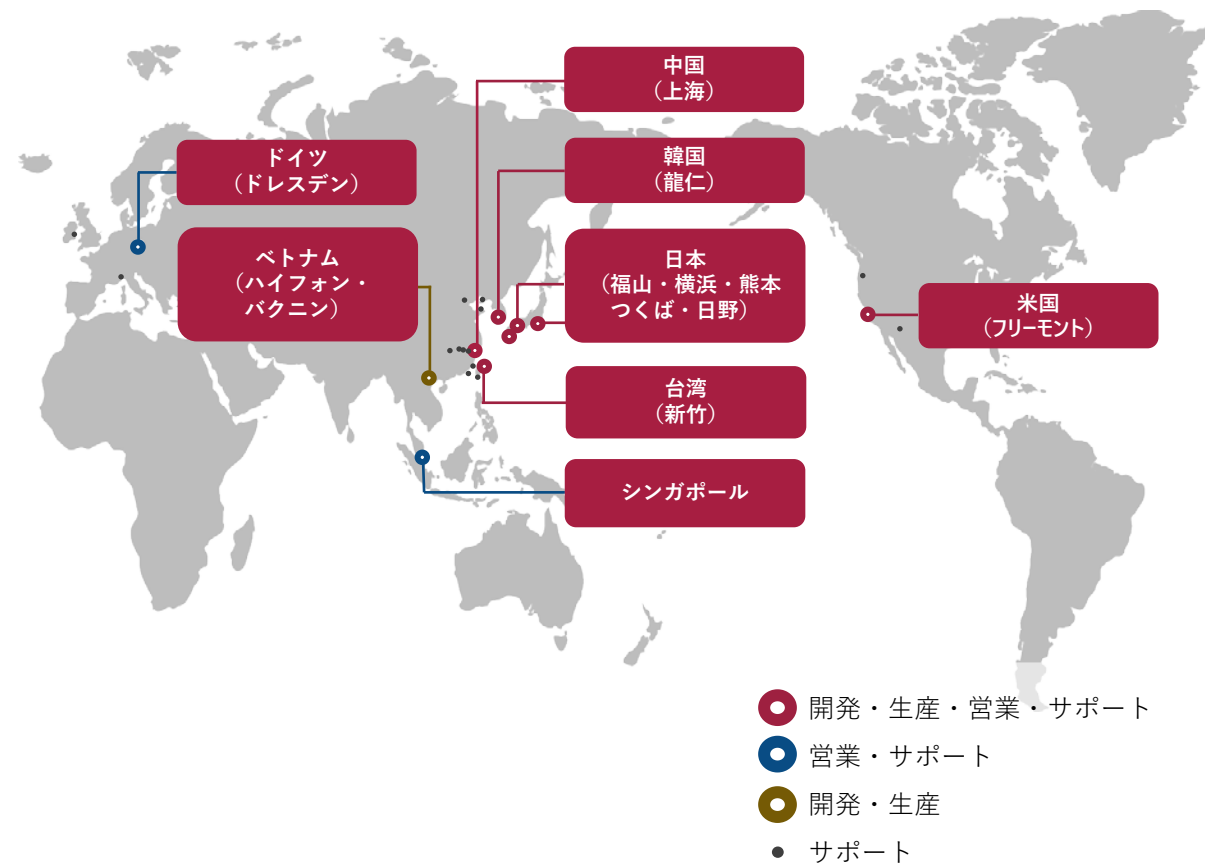
# 会社概要

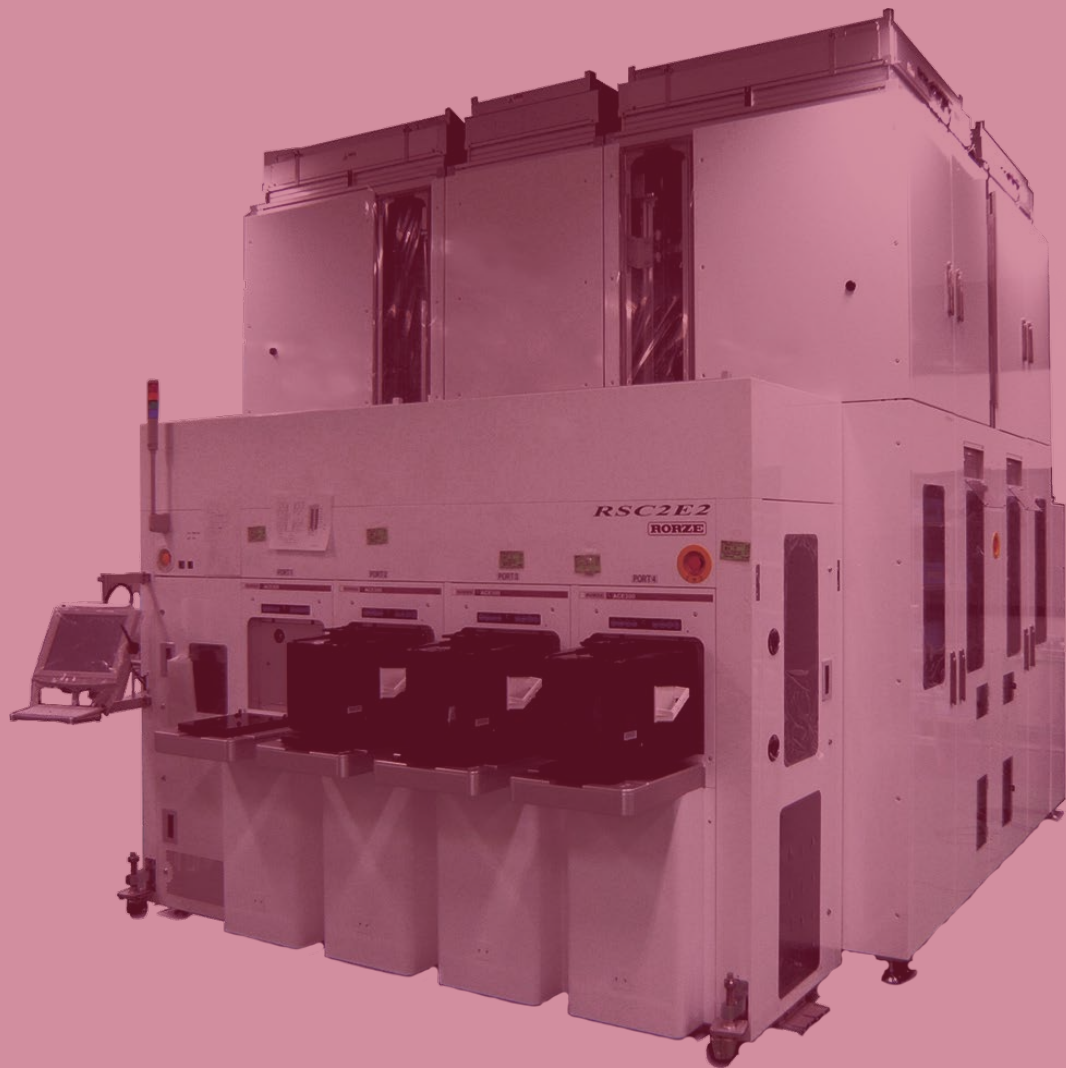
会社名	ローツェ株式会社（英文名；RORZE CORPORATION）
上場市場	東京証券取引所 プライム市場（証券コード：6323）
所在地	広島県福山市神辺町
設立	1985年3月30日
資本金	982百万円
事業内容	半導体・フラットパネルディスプレイ（FPD）・ライフサイエンス関連の自動化・搬送装置の開発・製造・販売
従業員数	連結：4,026名 当社：248名（2024年5月末現在）
事業拠点	国内：福山・横浜・熊本・つくば・日野 海外：米国・ベトナム・台湾・韓国・シンガポール・中国・ドイツ

従業員数の推移（連結）



## グローバルネットワーク



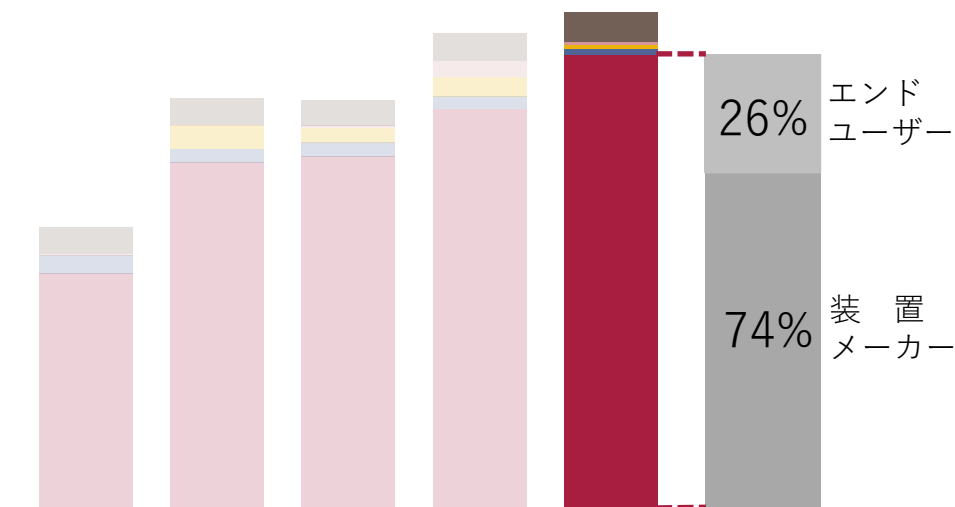


2025年2月期（第40期）  
第1四半期（2024年3月～2024年5月）  
連結業績

# 業績ハイライト

■ 中国向け主体に半導体関連装置売上が堅調、円安による為替差益もあり増収増益

■ 売上高	29,288 百万円	前年同期比 +75.5%
■ 営業利益	8,748 百万円	+85.4%
■ 経常利益	11,361 百万円	+118.1%
■ 四半期純利益	8,774 百万円	+146.7%

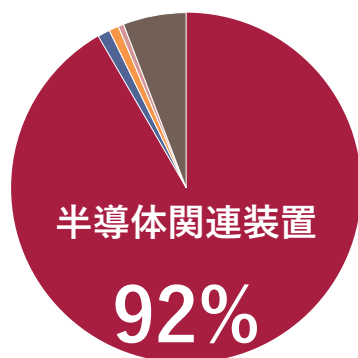


## 為替レート

(円/USD)		
Q1 FY'23	Q1 FY'24	FY'24 業績予想
133	147	144

※ 当期より業績予想および実績は期中平均レートを使用

## 売上構成比



## 四半期売上高

	Q1 FY'23	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'24
■ 部品・修理 他 ※	1,543	1,582	1,490	1,638	1,705
■ ライフサイエンス関連装置	100	52	148	919	152
■ FPD関連装置	346	1,368	846	1,152	262
■ 分析装置	715	805	849	742	331
■ 半導体関連装置	13,987	20,489	20,836	23,632	26,836

※ 当期より「モータ制御機器」は「部品・修理 他」に含めて集計しております。

# 2025年2月期 第1四半期連結業績

## ■ 半導体関連装置の売上増加、円安による為替差益もあり増収増益

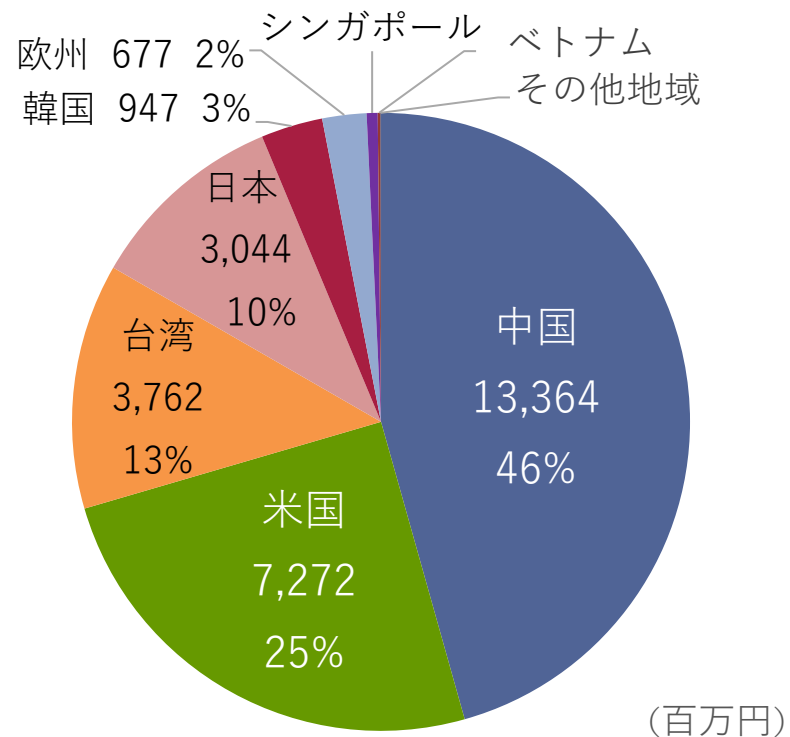
(百万円)

	FY'24 Q1 実績	FY'23 Q1 (前年同期)	前年同期比 (%)	FY'23 Q4 (前四半期)	前四半期比 (%)
売上高	29,288	16,693	175.5	28,085	104.3
半導体関連装置	26,836	13,987	191.9	23,632	113.6
分析装置	331	715	46.3	742	44.7
FPD関連装置	262	346	75.7	1,152	22.8
ライフサイエンス関連装置	152	100	152.1	919	16.6
※ 部品・修理 他	1,705	1,543	110.5	1,638	104.1
営業利益	8,748	4,718	185.4	8,375	104.4
経常利益	11,361	5,208	218.1	5,750	197.6
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益	8,774	3,557	246.7	4,088	214.6

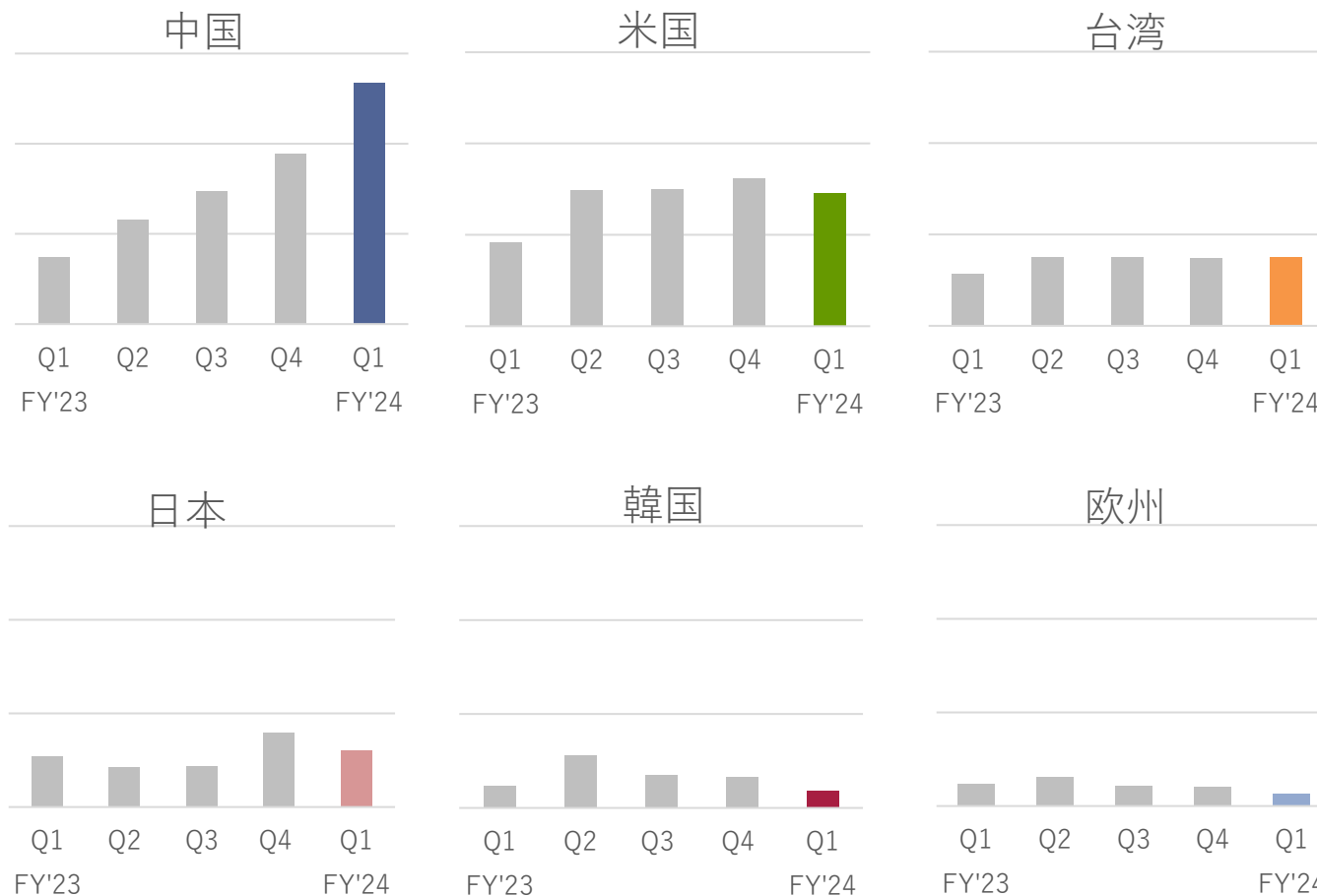
※ 当期より「モータ制御機器」は「部品・修理 他」に含めて集計しております。

# 地域別売上高

■ 中国向けが前Q1から4四半期連続の増加、米国向けを超え首位に



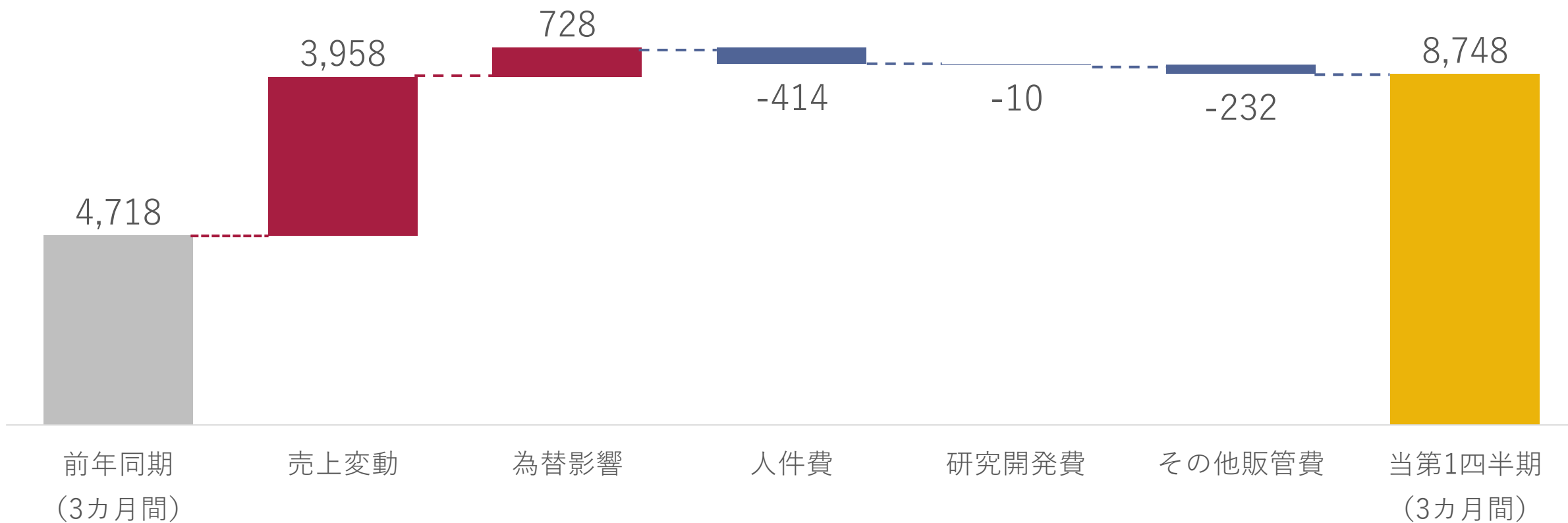
※ 「地域別売上高」は販売先の所在地別に集計



# 営業利益

## ■ 半導体関連装置の売上増加により増益

(百万円)

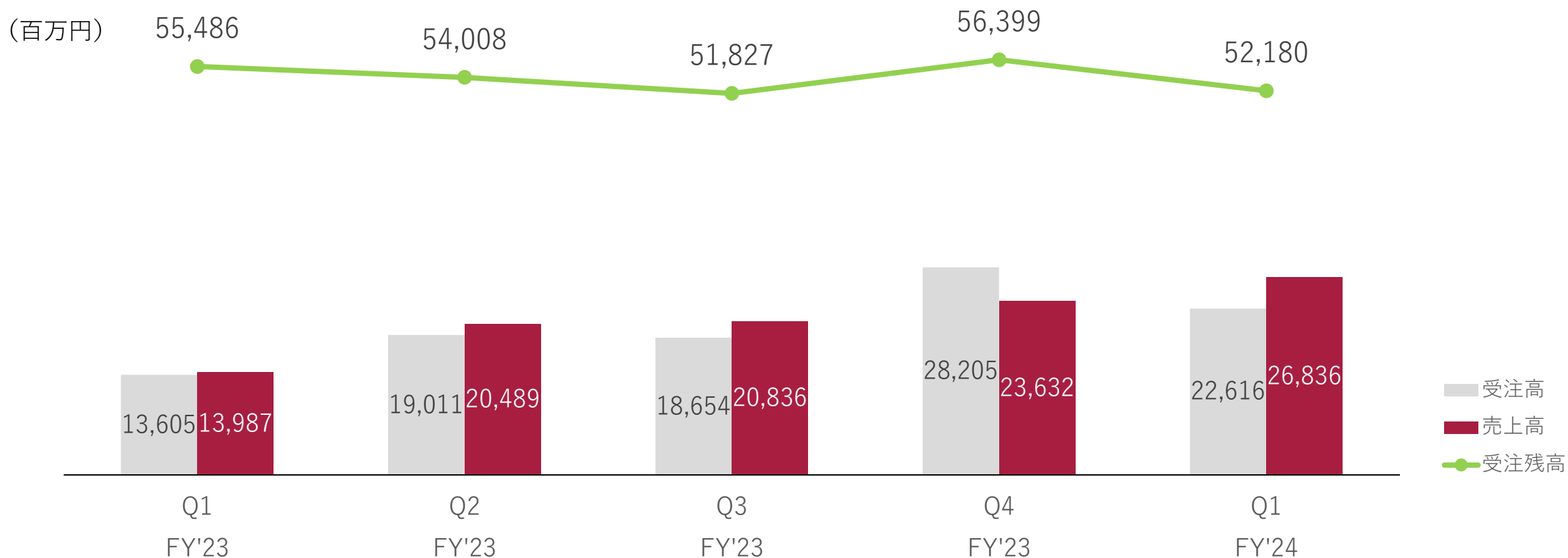




# 受注高・売上高・受注残高の推移

## 半導体関連装置

- ・前四半期に集中した受注の反動減により受注高はQoQで減少したが依然高水準を確保し堅調、売上増加により受注残高は減少

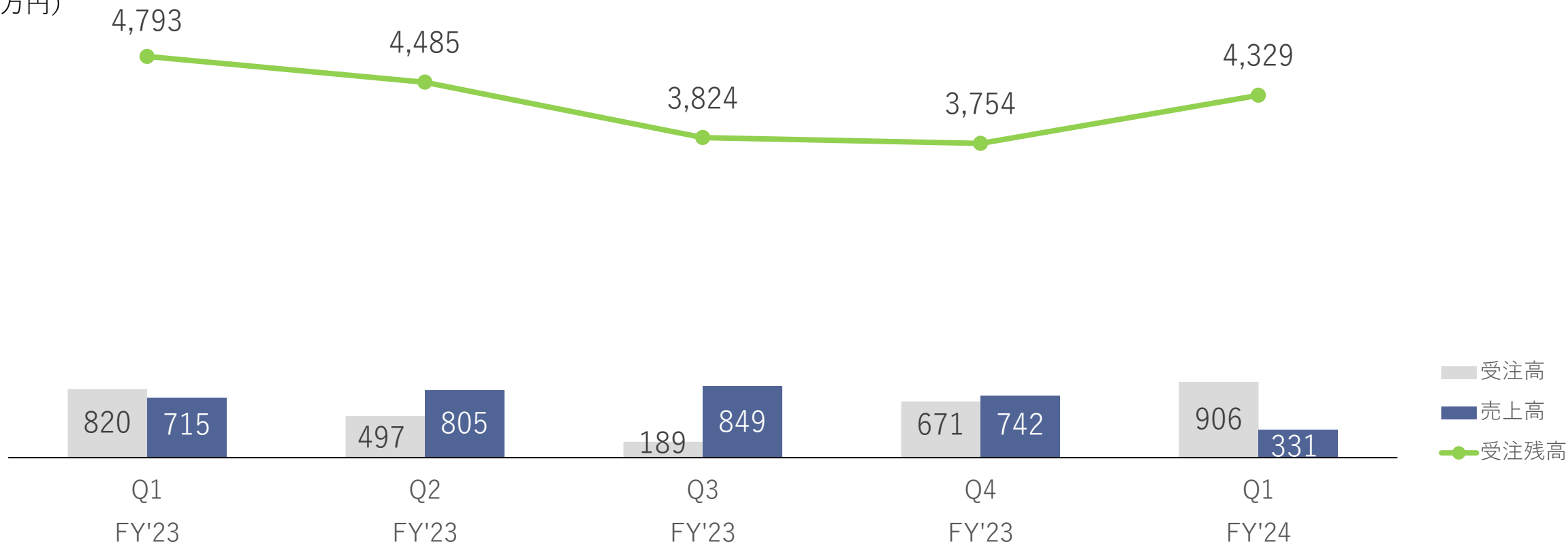


# 受注高・売上高・受注残高の推移

## 分析装置

- ・ 客先での装置立上げの遅れや検収待ちにより売上減少、主力製品の受注は前四半期より増加傾向

(百万円)

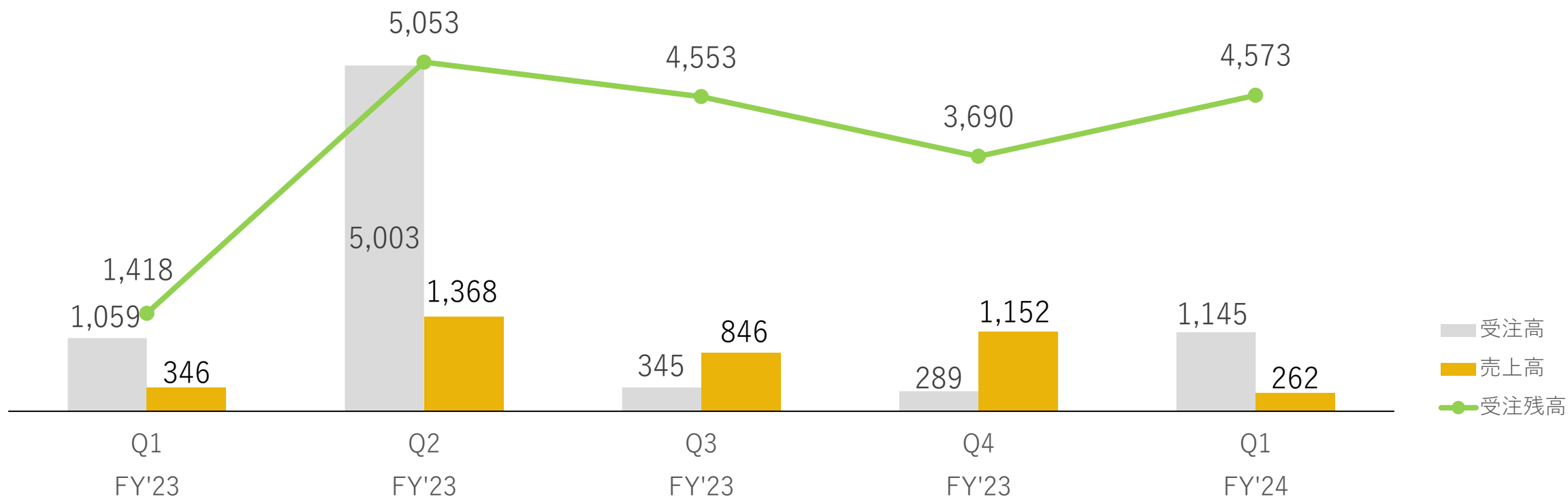


# 受注高・売上高・受注残高の推移

## FPD 関連装置

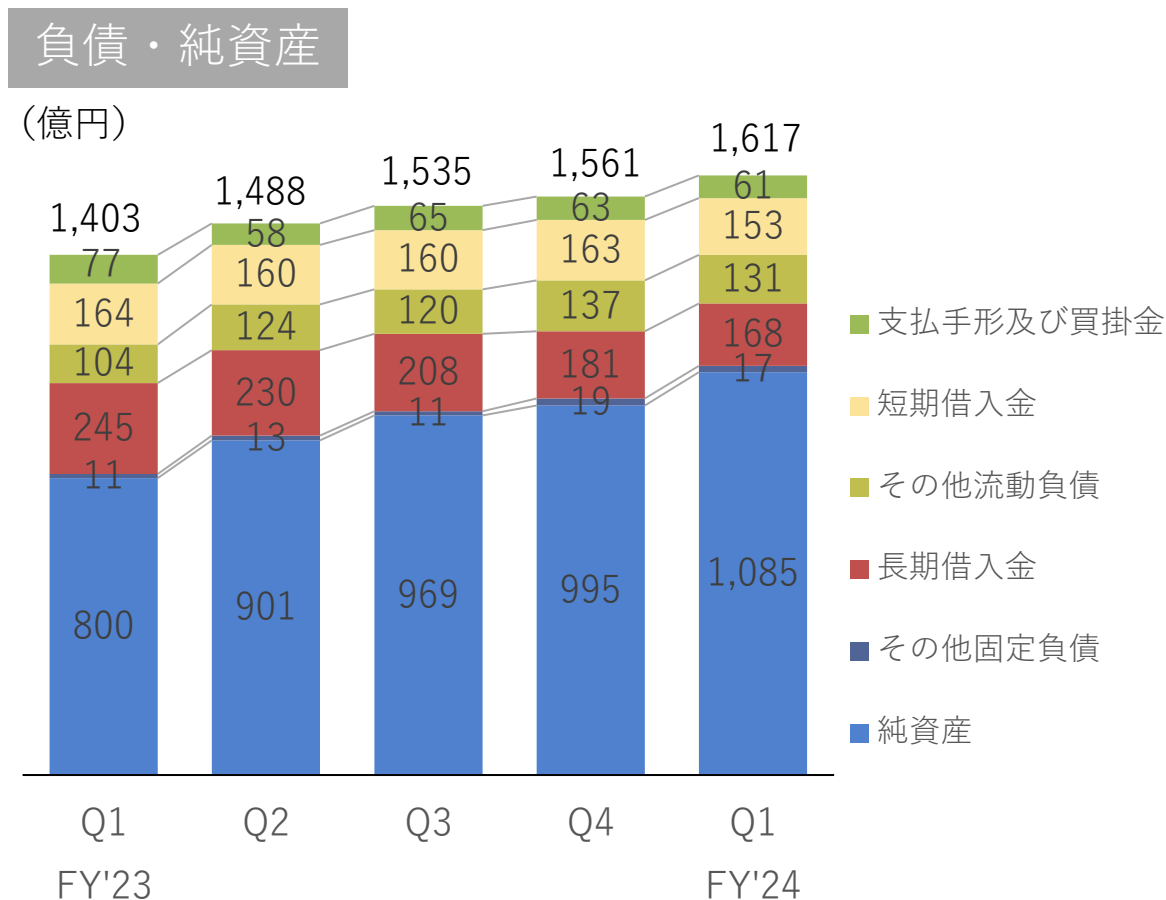
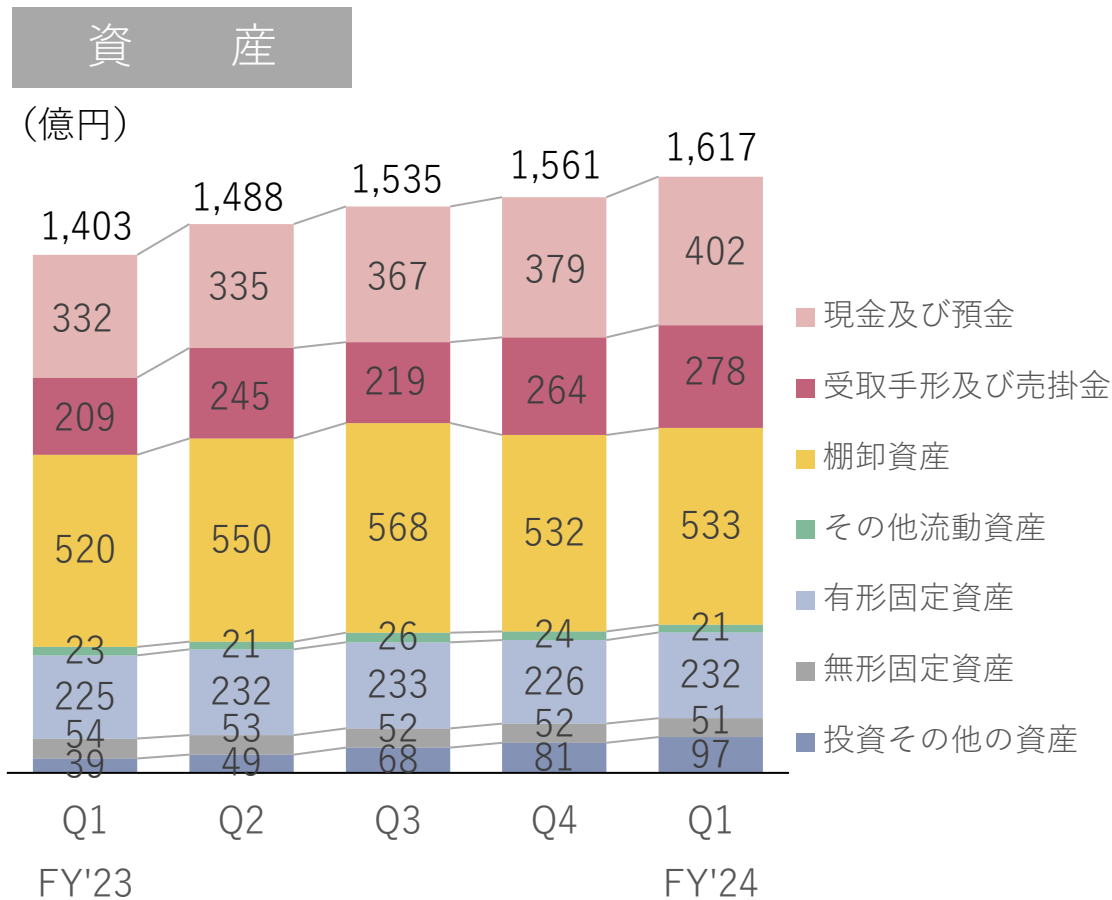
- ・当四半期は客先納入進まず売上に一服感があるものの、受注高は堅調
- ・前Q2に一括受注した前工程用大型搬送システムはQ2に納入予定

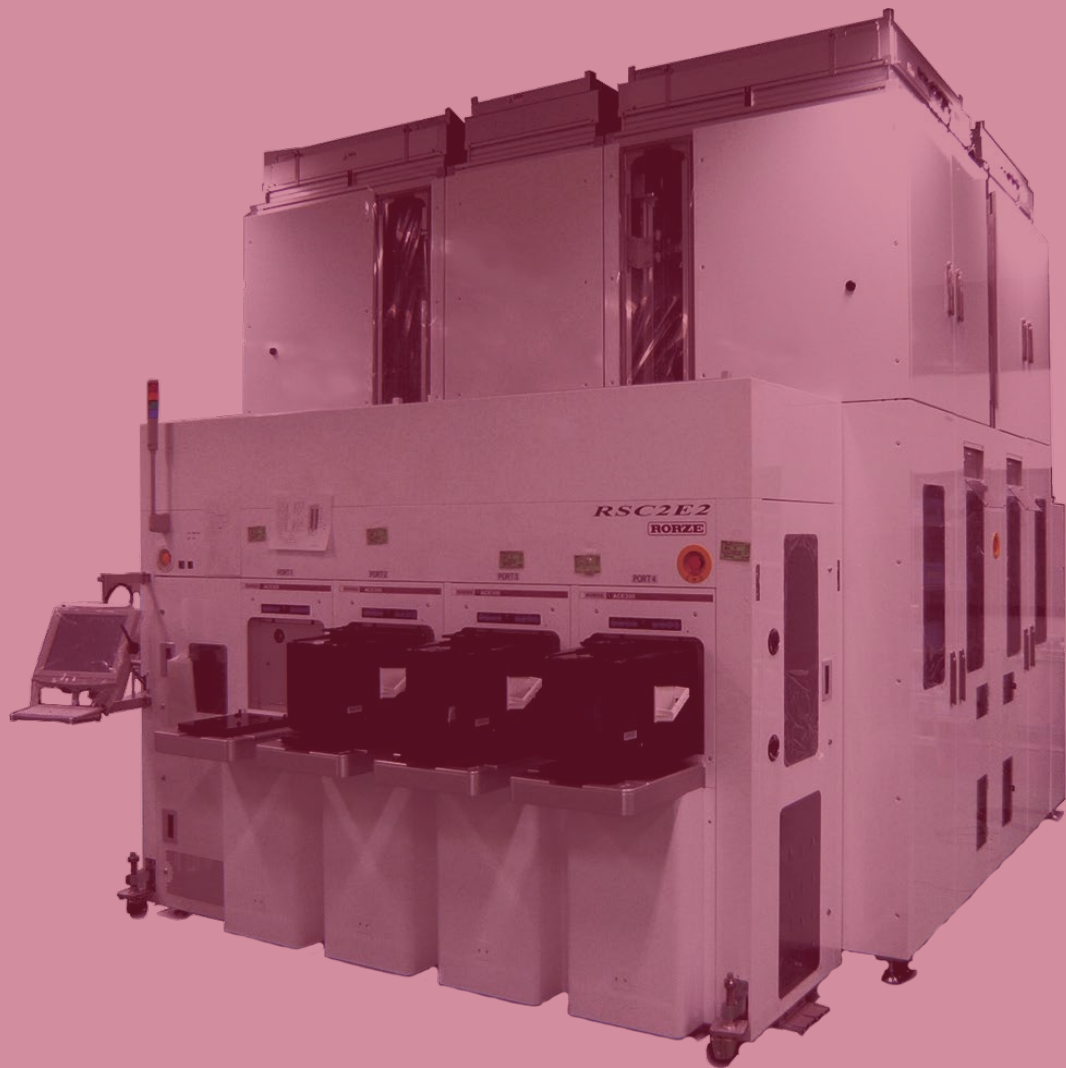
(百万円)



# 連結貸借対照表

## ■ 半導体関連装置の受注増により棚卸資産は依然高水準





2025年2月期（第40期）  
今後の見通し

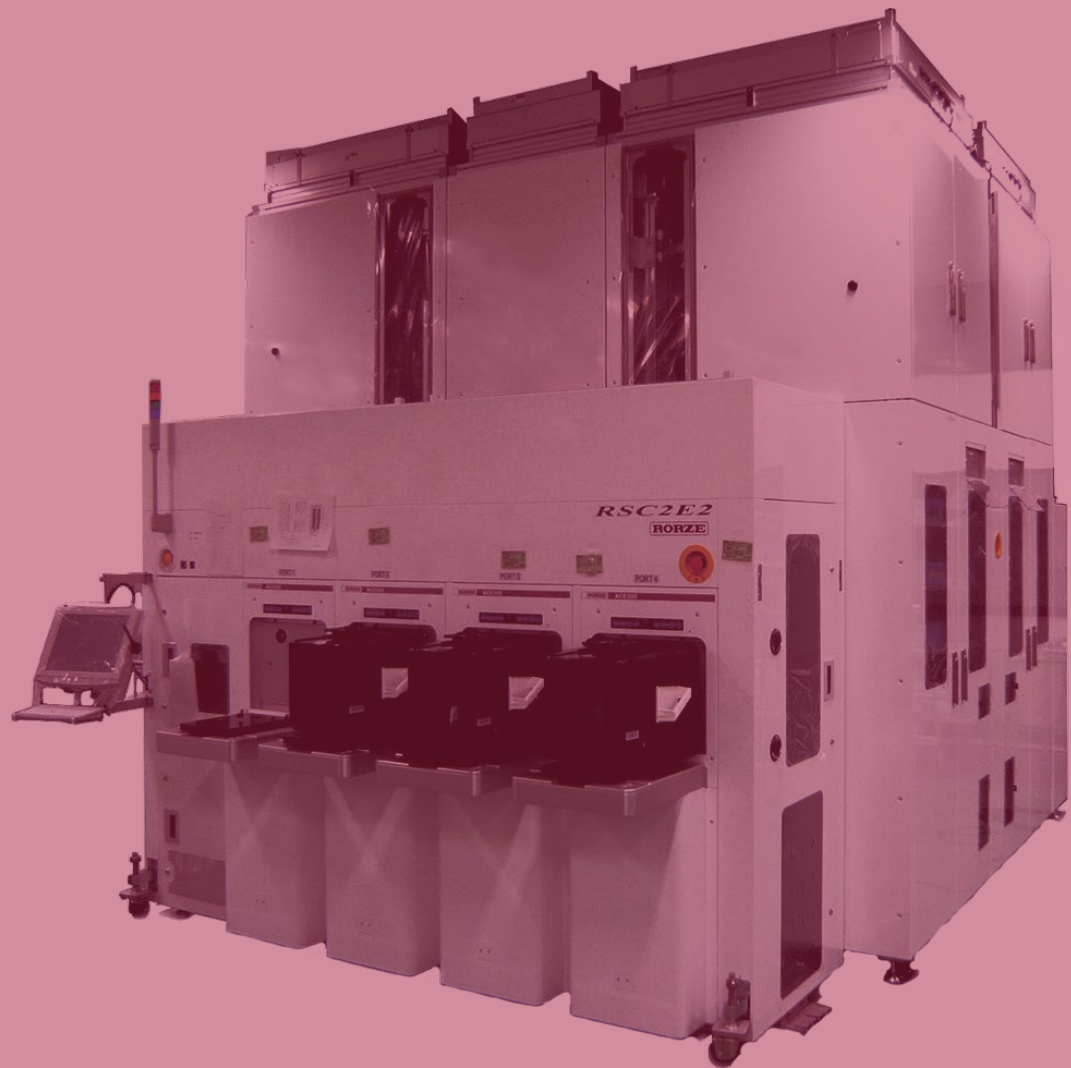
# 2025年2月期 業績予想に対する進捗

## ■ 中国、米国、台湾向け事業見通し堅調、業績予想に変更なし

(百万円)

	FY'24 Q1 実績	FY'24 Q2 累計予想	Q2予想 進捗率(%)	FY'24 通期予想	通期予想 進捗率(%)
売上高	29,288	61,474	47.6	120,784	24.2
半導体関連装置	26,836	52,099	51.5	102,399	26.2
分析装置	331	2,373	14.0	3,841	8.6
FPD関連装置	262	3,348	7.8	6,511	4.0
ライフサイエンス関連装置	152	311	49.1	1,300	11.8
※ 部品・修理 他	1,705	3,342	51.0	6,732	25.3
営業利益	8,748	17,298	50.6	31,617	27.7
経常利益	11,361	17,300	65.7	31,518	36.0
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益	8,774	12,604	69.6	22,916	38.3

※ 当期より「モータ制御機器」は「部品・修理 他」に含めて集計しております。



## トピックス

# Nanoverse Technologies, Ltd.への出資

## 会社概要

会社名	Nanoverse Technologies, Ltd.
所在地	米国・オレゴン州
事業内容	半導体製造装置の開発・製造・販売
設立年月	2022年7月
従業員数	35名（2023年12月31日現在）

- 出資額：70百万ドル（158円/ドル換算で約110億円）
- 出資後の当社持分割合：33%（連結子会社）
- 当社製搬送装置(EFEM)の取引先
- アドバンスドパッケージ分野で新たな半導体製造装置を開発、評価機納入予定
- 今期の業績に与える影響については精査中

### 計測



ヘテロダイナ光学分光法、  
エリプソメトリー、干渉計

### レーザー加工



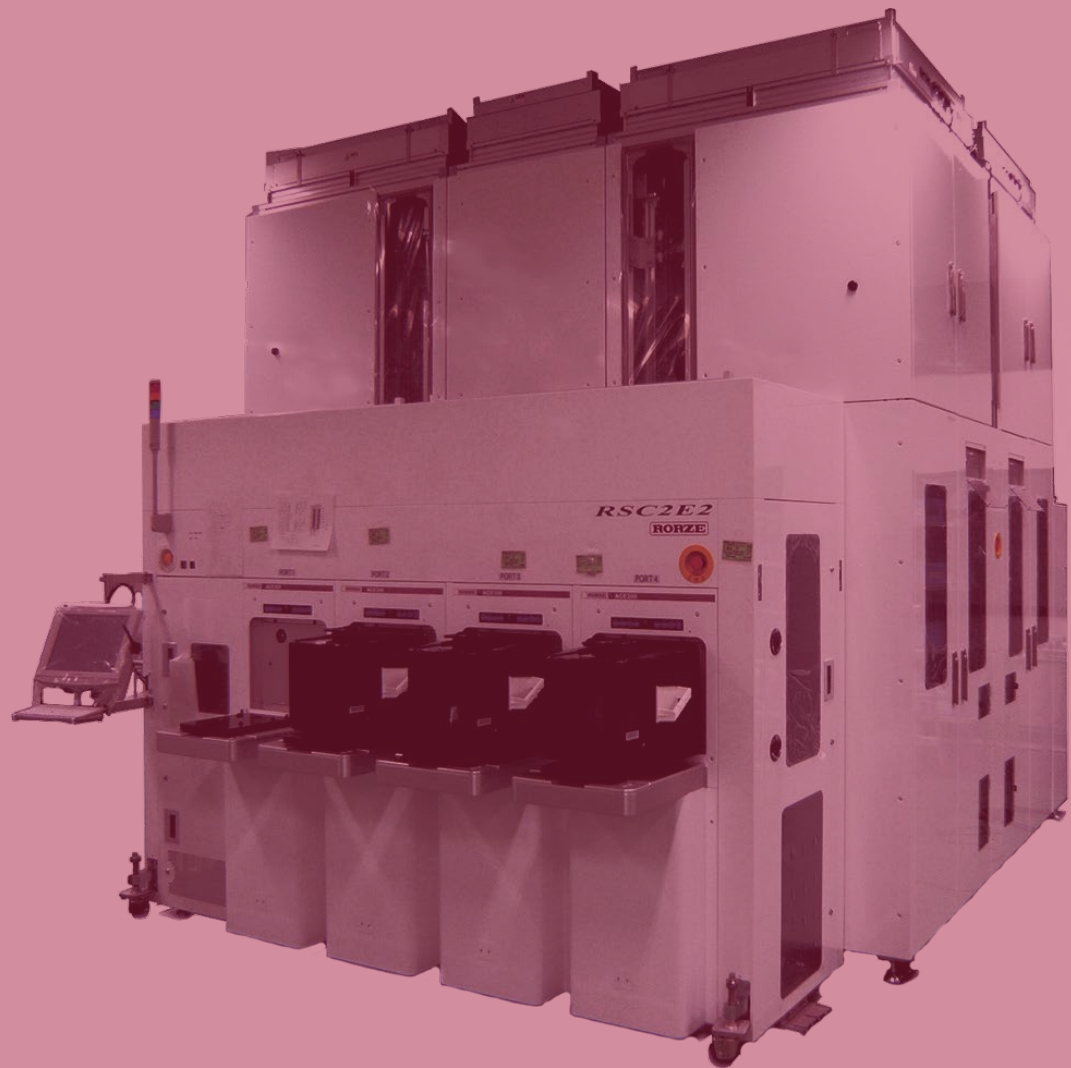
独自技術による  
高速レーザー加工

### データインテリジェンス



自動化とプロセス開発データの  
深い理解





# 参 考 资 料

# 半導体関連装置

**RORZE**

ユニット



大気用搬送ロボット



アライナ



ロードポート

システム



EFEM



真空プラットフォーム

システム



ウエハソータ



N2パージウエハストック

装置メーカー

プロセス装置

検査装置

エンドユーザー

デバイスメーカー

ウエハメーカー

# アドバンスドパッケージ用装置

## アドバンスドパッケージ

より小さいフットプリントで高いデバイス密度と機能拡張を実現できるようにチップレットを接続する方法

### ■PCB(プリント基板)上でのパッケージング

**前工程** 1 ウェハで1種類のチップ

これまでのローツェ搬送装置の市場

**後工程** 1 パッケージで1種類のチップ

PCB基板上にマウンターでパッケージング  
(各半導体間はPCB基板を通じて通信)

### ■シリコンウエハ上でのパッケージング

**中工程** 後工程のパッケージングをする代わりに、  
・ ウェハを薄くしてシリコンを貫通する通信用の縦穴形成 (TSV: Through Silicon Via)  
・ インターポーザ (※) 上で**複数のウェハを3Dに積層する**

ローツェの搬送装置が必要な新市場が拡大 (前工程 + 中工程)

#### ● アドバンスドパッケージ用装置

- ・ Tape Frame Sorter
- ・ PLP EFEM など

※インターポーザ: 貫通電極によって表裏の回路の導通をとり中継する基板  
(シリコンインターポーザ、ガラスインターポーザ、有機インターポーザ)

# アドバンスドパッケージ用装置



PLP用EFEM



Tape Frame用ソーター



# 分析装置



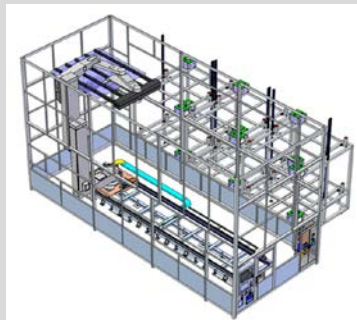
半導体業界  
製造装置メーカー  
エンドユーザー  
デバイスメーカー  
ウエハメーカー

半導体業界以外  
研究機関  
環境計測機器  
化学薬品メーカー  
など

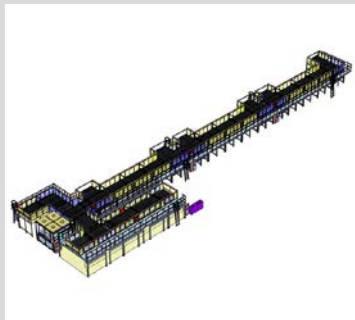
# FPD関連装置

**RORZE**

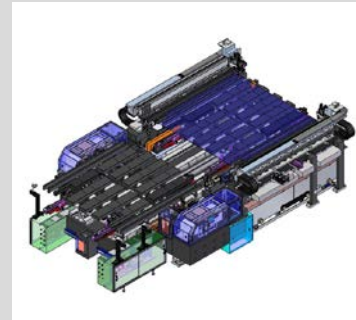
ローツェシステムズ  
(韓国子会社)



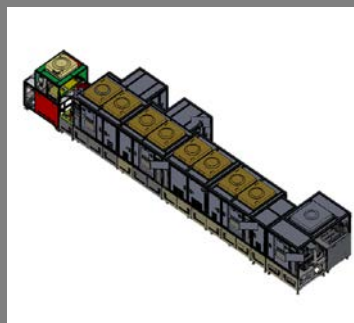
INDEX超大型搬送システム



インライン搬送システム



レーザーカッティング装置



ディスプレイモジュール機器



Packing 超大型Cell装置



前工程：

FPDメーカー  
FPD用ガラスメーカー



後工程：

FPDメーカー



# ライフサイエンス関連装置



インキュベータ  
SCALE48



自動培地交換機能&細胞観察  
機能付きCO2インキュベータ  
CellKeeper® II 48Plus



モバイルロボット



全自動培地交換システム  
CellFarm(L)-360™



スケジューリングソフトウェア  
Green Button Go™ ※  
(※Biozero社製)



大学・製薬企業等  
研究機関  
再生医療関連企業



ありがとうございました

